

## 主席報告書

本人謹代表董事會（「董事會」）欣然提呈福邦控股有限公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零三年十二月三十一日止年度之全年業績。

### 財務業績

木材業界之激烈競爭影響本集團二零零三年度之業績。此外，由於高科技相關業務仍處於投資階段，故有關業務之盈利貢獻將於日後之業績報告中反映。

年內，本集團錄得營業額28,114,000美元，而去年則為31,505,000美元。毛利上升150%至2,836,000美元。淨虧損由13,584,000美元大幅收窄至4,653,000美元，減幅高達65.7%。每股基本虧損為0.05美仙。

營業額下跌主要是由於本集團出售兩家木材附屬公司，加上福華先進微電子股份有限公司（「福華先進」）之股權架構出現變動所致。福華先進原為本公司之附屬公司，現變為本公司之聯營公司。因此，該等公司之營業額不再計入本集團之綜合財務報表。此外，由於市場競爭激烈，本集團木材業務之銷售額亦告微跌。

淨虧損得以收窄，原因為撇除了於二零零二年以物業、廠房及設備已確認之減值虧損及發行優先股份予福華先進少數股東作為出售福華先進部份權益而錄得之虧損，以及旗下兩間附屬公司進行合併而攤薄本集團對附屬公司之股本權益。

### 股息

董事會不建議就截至二零零三年十二月三十一日止年度派付末期股息。

### 業務回顧

#### 木材業務

木材業界之激烈競爭令毛利率維持低水平及本集團之木材業務錄得虧損。然而，優質的產品仍能在市場上享有優勢。

本集團擁有67%權益之附屬公司吉林福敦木業有限公司（「福敦」），是國內的主要模壓門皮供應商。隨著國內建造業蓬勃發展，其配套行業將享有長遠穩定之發展前景。憑藉穩定可靠之生產實力，加上遍佈廣州、上海及北京等地之分銷網絡，福敦正處於有利位置，當可穩奪區內湧現之商機。

# 主席報告書

---

## 業務回顧 (續)

### 高科技相關業務

為了抓緊全球高科技市場之商機，本集團在過去數年極力發展高科技相關業務，特別是系統整合晶片解決方案及設計服務。系統整合晶片為高度整合的集成電路，於一片晶片中嵌入精密的系統及裝置。系統整合晶片是傳統集成電路之提升版，其有助縮細產品體積及減低生產成本，在現今由高科技帶動且瞬息萬變之年代具有龐大發展潛力。

本集團專注於技術項目之分支機構－福華先進，為無廠房原設計系統整合晶片集成裝置製造商（「ODM」），業務目標是為大中華地區之半導體市場提供系統整合晶片及以系統整合晶片為本之解決方案。福華先進致力於系統整合晶片之設計工作，製造工作則外判予大中華地區之合約製造服務供應商。

為了拓展市場覆蓋層面，福華先進於二零零三年一月及二零零三年九月分別在加州及上海設立辦事處，此舉令福邦準備就緒，可乘著市場不斷增長之勢發展成為強大的公司。

為了進一步加強設計實力，福華先進於二零零三年七月透過配售股份，與三菱商事株式會社（「三菱」）及台灣三菱商事股份有限公司（「台灣三菱」）結盟。透過上述聯盟，福華先進不單可取用日本公司之知識產權，亦可進一步提升其大型集成電路開發實力，更可增加國內潛在客戶對福華先進之認受性，以及推進福華先進發展成為大中華地區之領導集成電路設計公司之一。

### 未來計劃及前景

展望未來，福邦將繼續改善整體營運效率，在木材業務方面將集中資源於旗下錄得盈利之業務。此外，福邦亦會協助旗下附屬公司及聯營公司發展海外市場，拓展銷售渠道及加強品牌形象。

高科技相關業務之營運歷史僅為三年，與木材業務相比無疑屬本集團較新業務。然而，由於系統整合晶片市場於未來數年將持續增長，預期是項業務將會成為本集團業績之主要來源，且於未來的日子裡將會錄得更高更快的增長。

半導體整合元件廠、無廠房公司及電子製造商之外判安排日漸普遍，為福華先進帶來無限商機。作為無廠房系統整合晶片ODM之一，福華先進專門設計的複雜集成電路以及為此等集成電路提供軟件和全面工程支援，其核心能力在於為資訊電子行業提供服務，包括無線及寬頻通訊及數碼消費電子行業。

---

## 主席報告書

---

### 未來計劃及前景 (續)

為配合市場需要，我們將於二零零四年第二季推出優質的ODM新產品，包括通用串行總線（「USB」）2.0閃快記憶控制器及USB2.0多重記憶讀卡器。我們的新產品價格極具競爭力、品質優異兼且功能多樣化，因此本集團有信心可爭取大量新訂單。

除了系統整合晶片設計服務以外，福華先進更設有內部研發組，可設定、發展及推廣「以平台為本之系統整合晶片」產品。該等以平台為本之系統整合晶片以通用架構設計，專為某些應用區位而設，可協助系統工程師度身設計不同的產品功能，而毋須改變基本之架構設計，有助縮短產品推出市場的時間。

除了為客戶提供集成電路設計及以平台為本之系統整合晶片服務外，福華先進更提供再設計服務。福華先進協助不少大型品牌晶片公司重新設計舊產品，加入新的晶圓處理技術及新鑄造法，以減低成本、加強功能、降低地域風險及加速生產的要求。這項服務須具備豐富經驗及超卓知識，方能提供。

福邦管理層具備廣泛的人事脈絡及對科技的專門認識，是公司的一大優勢。我們的多位高級管理人員特別在集成電路設計及服務等方面，具備豐富的經驗。加上全面的系統整合晶片設計及服務，福邦在快速增長的高科技市場，正處於極有利位置，當可充分發揮公司的潛力。我們有信心為股東帶來回報。

### 致謝

本人謹此代表董事會向全體股東、董事、員工、客戶、供應商及業務夥伴致意，感謝他們對本集團一直以來之鼎力支持。我們期待著本集團於來年再創佳績。

承董事會命

主席

楊丁元

香港，二零零四年四月二十三日